



技术要求

1. 未注尺寸公差±0.1。
2. 未注倒角C0.5。

			热处理	表面处理
				代号 SY-COM-16-DIO-05-NPN
变更版本	变更人签字	日期	材料	名称 串口IO模块
设计			重量	比例 1:1
制图			精度等级	深圳市双翌 光电科技有限公司
校对			共张	
审核			第张	